

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年4月30日(30.04.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/085183 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01) *H01L 21/52* (2006.01)
C09J 5/02 (2006.01) *H01L 25/065* (2006.01)
C09J 5/06 (2006.01) *H01L 25/07* (2006.01)
C09J 201/00 (2006.01) *H01L 25/18* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2019/040845

(22) 国際出願日: 2019年10月17日(17.10.2019)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2018-202212 2018年10月26日(26.10.2018) JP
特願 2019-101252 2019年5月30日(30.05.2019) JP

(71) 出願人: 三井化学株式会社 (MITSUI CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒1057122 東京都港区東新橋一丁目5番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 茅場 靖剛 (KAYABA, Yasuhisa); 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 鎌田 潤 (KAMADA, Jun); 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 中村 雄三 (NAKAMURA, Yuzo); 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP).

(74) 代理人: 中島 淳, 外 (NAKAJIMA, Jun et al.); 〒1600022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号 HK 新宿ビル7階 太陽国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: SUBSTRATE LAYERED BODY MANUFACTURING METHOD AND LAYERED BODY

(54) 発明の名称: 基板積層体の製造方法及び積層体

(57) Abstract: This substrate layered body manufacturing method includes: a step in which a bonding material is applied to the surface of a first substrate and/or a second substrate; a step in which the bonding material which was applied to the surface is cured so as to form a bonding layer for which the composite elastic modulus at 23°C is no more than 10 GPa; and a step in which the first substrate and the second substrate are bonded via the bonding layer which was formed.

(57) 要約: 第1の基板及び第2の基板の少なくとも一方の表面上に、接合材料を付与する工程と、前記表面上に付与された前記接合材料を硬化して23°Cにおける複合弾性率が10 GPa以下である接合層を形成する工程と、形成された前記接合層を介して前記第1の基板と前記第2の基板とを接合する工程と、を備える基板積層体の製造方法。



WO 2020/085183 A1